

財團法人中華經濟研究院 函

地址：台北市大安區長興街75號
聯絡人：李若箴
電子信箱：leegrace1136@cier.edu.tw
聯絡電話：02-27356006分機5264

受文者：國家科學及技術委員會科技辦公室

發文日期：中華民國115年8月3日
發文字號：華經研字第1150002498號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：2026台日科技高峰論壇_議程 (115120000858_1_2026台日科技高峰論壇_議程.pdf)

主旨：本院將於本（115）年8月21日舉辦「台日科技高峰論壇－從量子到AI應用」，惠請貴機關(構)派員及協助轉載訊息，請查照。

說明：

- 一、本案係受經濟部產業技術司委辦，訂於115年8月21日（星期五）假台北政大公企中心舉行。敬邀相關領域先進踴躍報名，共襄盛舉。活動議程詳如附件。
- 二、晶片製造技術已成國家安全與經濟自主之戰略核心，構建兼具技術可信度與供應鏈韌性之「民主供應鏈」，為理念相近國家之共同課題。台灣擁有全球頂尖之晶圓製造與先進封裝實力，日本則在關鍵材料、精密設備與量子技術基礎研究深具優勢，兩國技術高度互補，深化合作正逢其時。
- 三、本次論壇特別促成日本產業政策之關鍵決策者與台灣官方代表共同與會，並廣邀日本台灣交流協會、情報處理推進機構(IPA)、產業技術總合研究所(AIST)G-QuAT、伊藤忠商



事、全家便利商店、優貝克科技(ULVAC)等日方重量級機構，以及我方經濟部、國際半導體產業協會(SEMI)、工業技術研究院、鴻海精密工業、國立陽明交通大學等單位，橫跨政府、產業、學研各界，展現本次論壇之高規格與跨國對話深度。

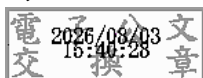
四、本活動提供公務人員終身學習時數及研習證明。

五、活動詳情及報名請見：<https://www.cier.edu.tw/conference-ch/32189/>。

六、聯絡人：李小姐，電話：(02)2735-6006分機5264。

正本：中華民國東亞經濟協會、中華民國工商協進會、國家科學及技術委員會科技辦公室、國家實驗研究院台灣半導體研究中心、國家實驗研究院國家儀器科技研究中心、財團法人工業技術研究院、財團法人國家衛生研究院、財團法人資訊工業策進會、財團法人精密機械研究發展中心、財團法人工業技術研究院服務系統科技中心、財團法人工業技術研究院資訊與通訊研究所、財團法人資訊工業策進會、日本台灣交流協會、中華民國全國工業總會、中華民國資訊軟體協會、中華民國精密機械發展協會、國際矽光子異質整合聯盟、台灣雲端物聯網產業協會、台灣物聯網產業技術協會、社團法人台灣智慧自動化與機器人協會、財團法人中技社、台北市電腦商業同業公會、台灣全球無線平台策進會、台灣科學園區科學工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、財團法人台灣網路資訊中心、台灣積體電路設計學會、台灣電路板協會、台灣光電暨化合物半導體產業協會、台灣奈米技術產業發展協會、台灣顯示器暨應用產業協會、台灣人工智慧晶片聯盟、台灣電子連接產業協會、中華民國自動化科技學會、群聯電子股份有限公司、台灣信越矽利光股份有限公司、台灣特品化學股份有限公司、中華精測科技股份有限公司、京鼎精密科技股份有限公司、閎康科技股份有限公司、中國砂輪企業股份有限公司、歲強科技股份有限公司、宏捷科技股份有限公司、台灣精測股份有限公司、宜特科技股份有限公司、德律科技股份有限公司、中央研究院物理研究所、光電科技工業協進會、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、友威科技股份有限公司、廣運機械工程股份有限公司、致茂電子股份有限公司、鈦昇科技股份有限公司、台灣資安鑄造股份有限公司、華苓科技股份有限公司、捷而思股份有限公司、可立可股份有限公司、瑞擎數位股份有限公司、東捷資訊服務股份有限公司、飛象資訊股份有限公司、鐸友益科技股份有限公司、翔名科技股份有限公司、辛耘企業股份有限公司、台灣英飛凌科技股份有限公司、科林研發股份有限公司、台灣新思科技股份有限公司、台灣恩智浦半導體股份有限公司、明遠精密科技股份有限公司、益力威芯股份有限公司、奈視科技股份有限公司、銳捷科技股份有限公司、泓議科技股份有限公司、磐石智慧科技股份有限公司

副本：



院長 連賢明



裝

訂

線

